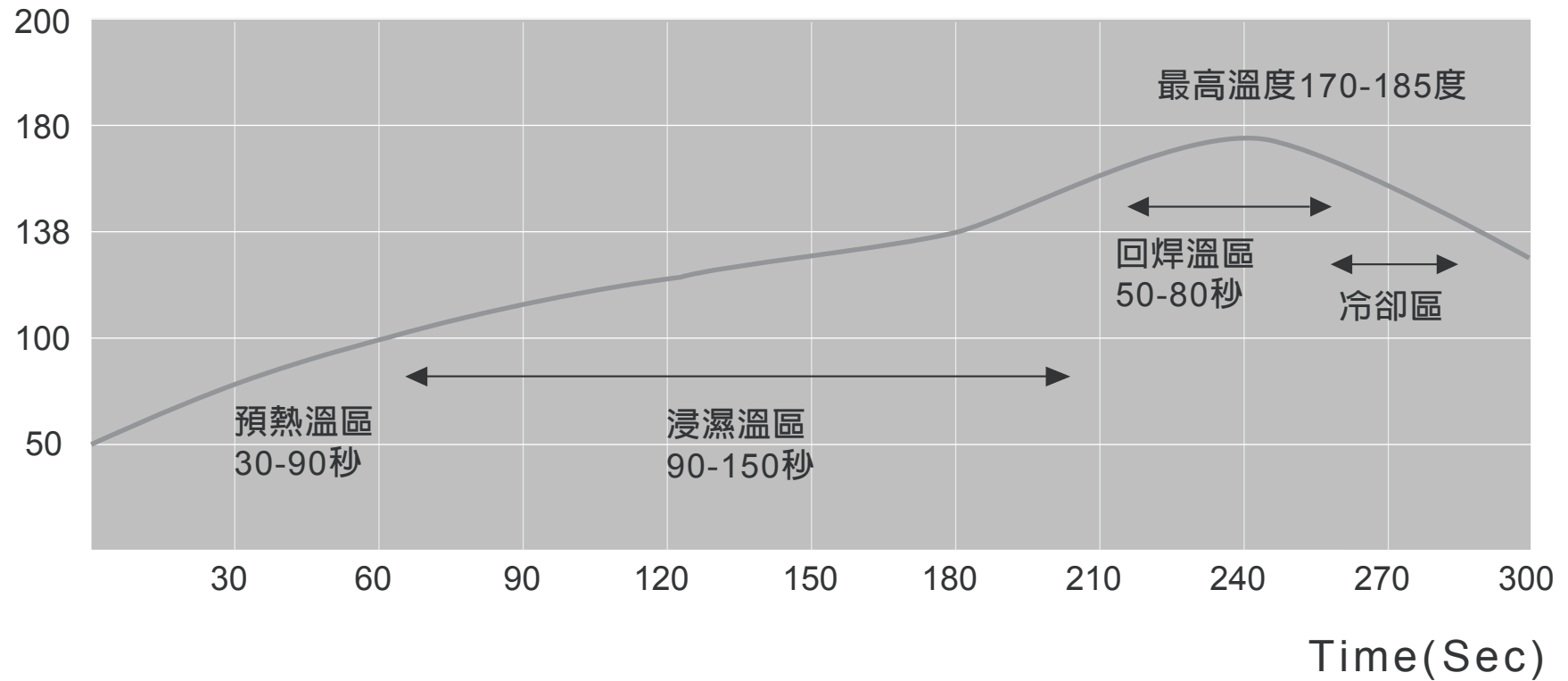


A Typical Reflow Profile For Lead-free Solder Paste LF3-981

Temperature(°C)



升溫區升溫斜率1-2°C/秒
25-110°C 預熱時間30-90秒左右
迴焊區時間138°C以上50-80秒

峰值溫度需要達到170-180°C
冷卻速度3-4°C/sec